



NLW2016AV2



产品特点 Features

- 符合 AEC-Q101
- ALN 基板封装，散热性能优良
- 完美光型易于匹配
- 光色空间一致性优异
- 湿气敏感等级 1
- 无铅产品，符合 RoHS 标准

产品应用 Applications

- 日行灯
- 矩阵大灯
- 位置灯
- 车牌灯
- 摩托车、电动车照明

产品规格 Specification ($T_j=25^{\circ}\text{C}$)

产品色温	显色指数	光通量		正向电压	发光角度	器件热阻
	典型值 @1000mA	典型值 @1000mA	典型值 @1500mA	典型值 @1000mA	典型值	典型值
6000K	70	325lm	435lm	3.15V	120°	4.5°C/W

说明：1. NLW2016AV2产品测试电流1000mA，测试时间20毫秒，环境温度25℃；

2. 发光角度为50%中心光强夹角，可提供ProSource\LightTools\TracePro\ASAP\ZEMAX等光学模拟软件需要的光源文档；

3. 因测量技术限制，产品测试存在测试误差，应指出ETi光通量和光功率测量值的公差为±7%，色坐标（CCx、CCy）测量值公差为±0.01，显色指数测试值公差为±2，电压测试误差±0.1V。

额定参数 Absolute Maximum Ratings

参数名称	额定参数
直流正向电流	1500mA
脉冲正向电流	2000mA
最大结温	150℃
工作温度	-40℃ - 125℃
储存温度	-40℃ - 125℃
焊接温度	JEDEC 020c 260℃
回流焊周期	3
反向电压	无反向操作设计

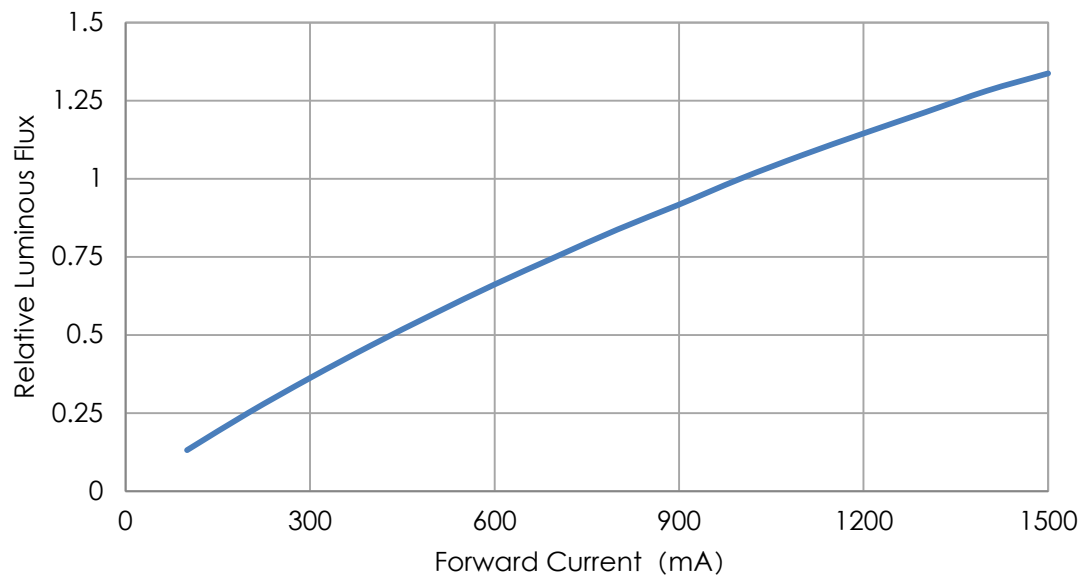
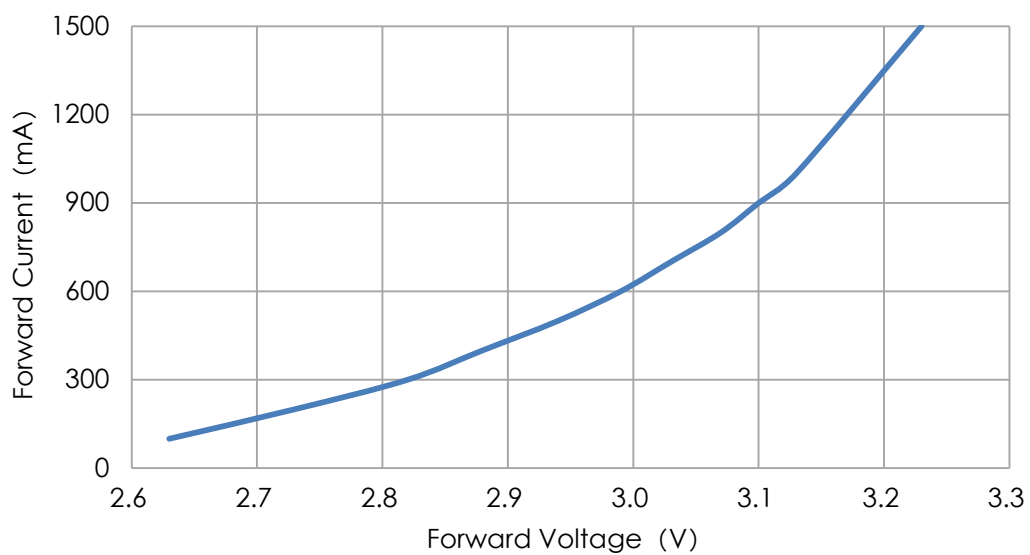
说明:

1. 最大正向电流或最大脉冲正向电流的先决条件是器件结温低于额定工作结温
2. 最大正向脉冲电流基于脉冲时间500毫秒、占空比0.1或者300毫秒，占空比0.3，1.0×1.0cm² MCPCB

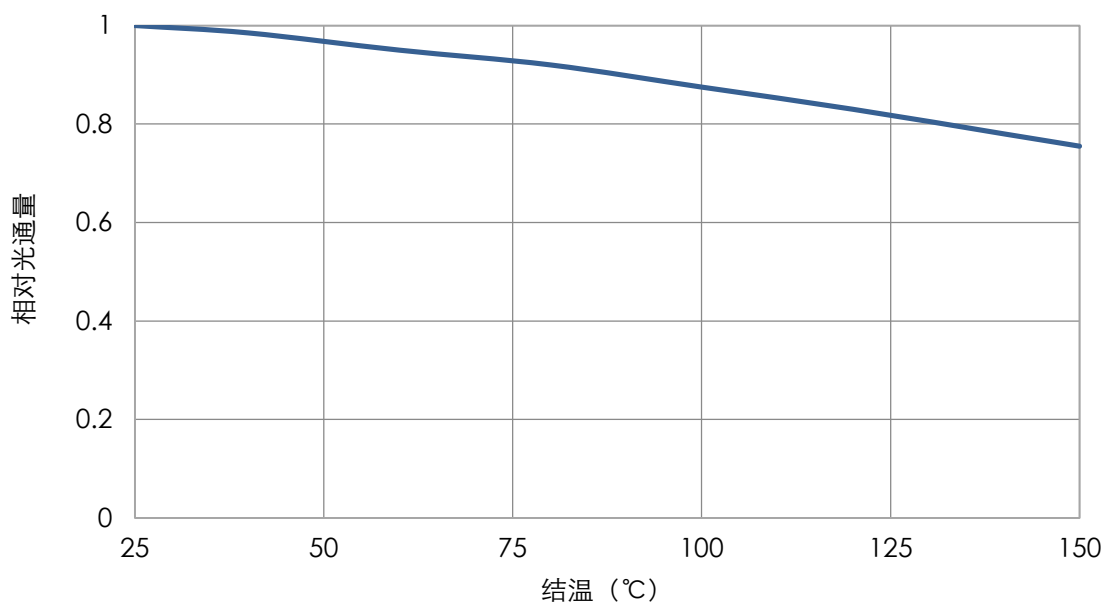
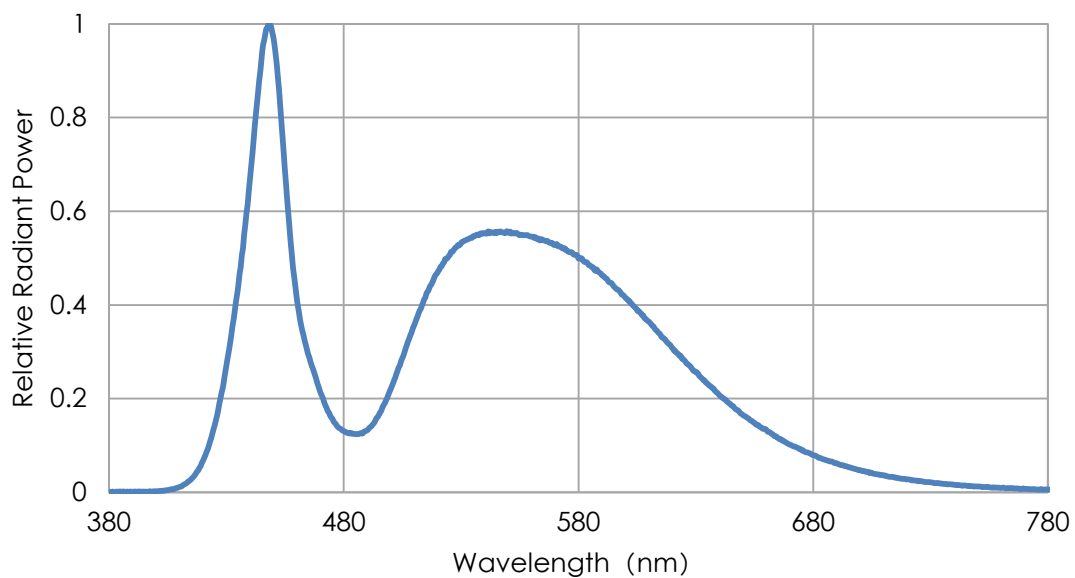
JEDEC Moisture Sensitivity

Level	车间寿命		筛选要求	
	时间	条件	标准	条件
1	Unlimited	≤30℃/85%RH	168h+5/-0h	85℃/85%RH

产品特征曲线

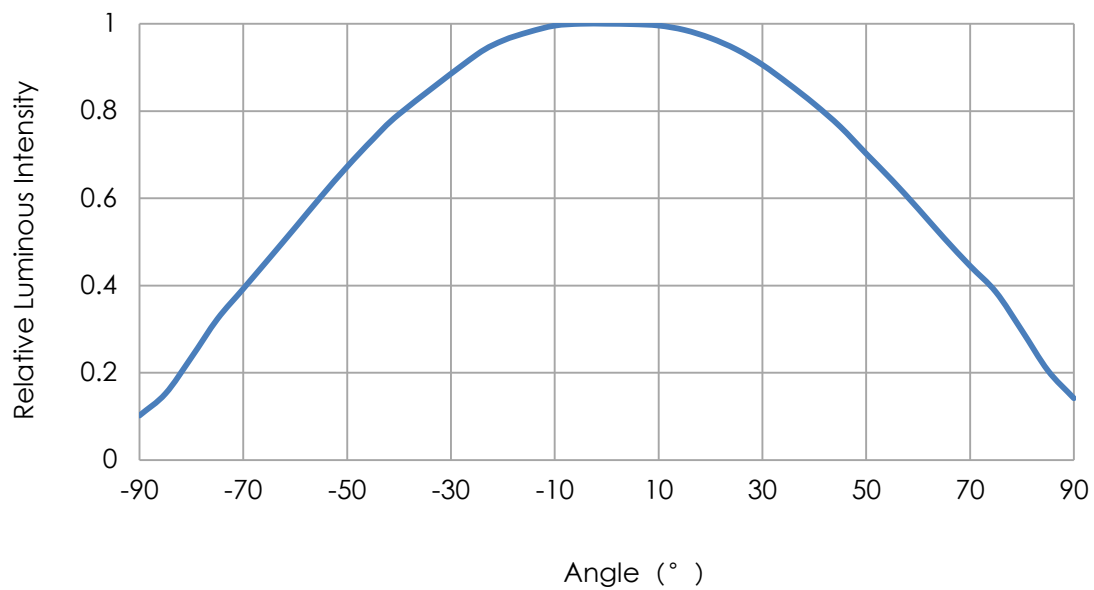
相对光通量 vs 正向电流
 $T_J=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 正向电压 vs 正向电流
 $T_J=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 

产品特征曲线

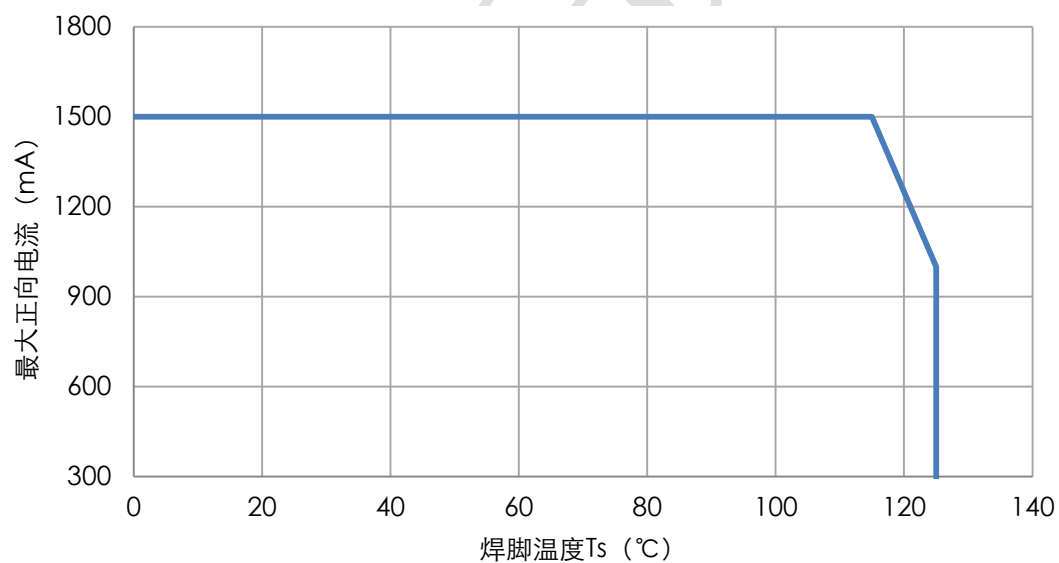
相对光通量 vs 结温
 $I_f=1000\text{mA}$ 相对辐射功率 vs 波长
 $I_f=1000\text{mA}$ 

产品特征曲线

相对光强 vs 角度

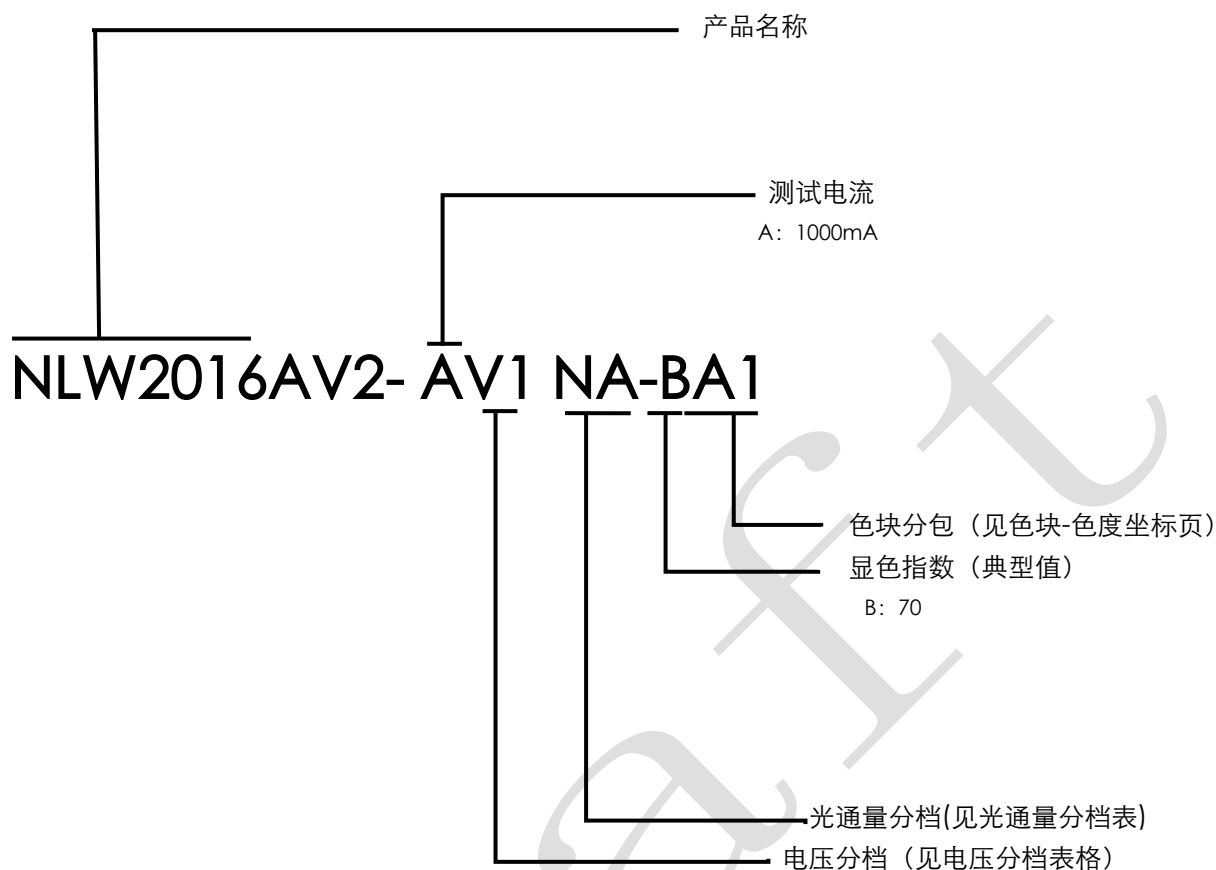


最大电流 vs 焊点温度



注：驱动1500mA时请确保LED焊点温度不超出115℃，否则请降低电流使用

产品命名 Part Number Nomenclature



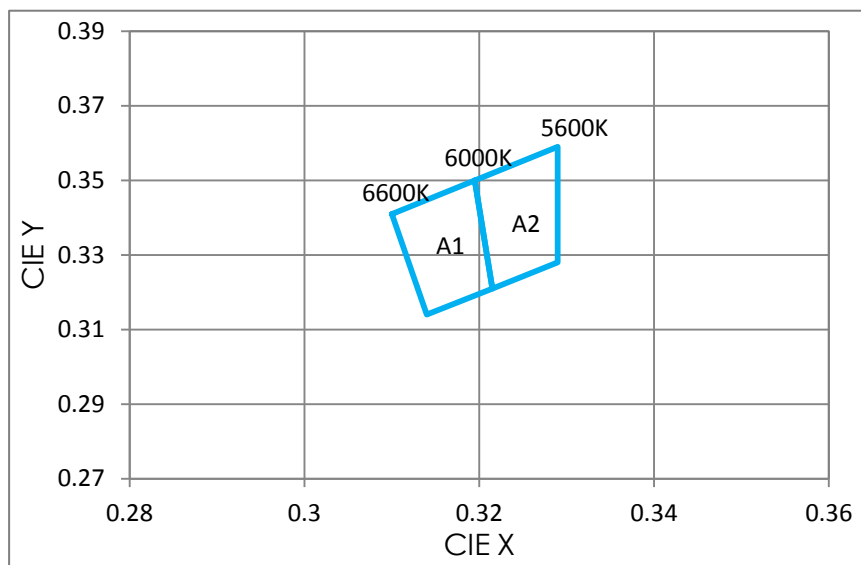
光通量分档

Group Code	Unit	Min	Max
NA	lm	275	300
NB		300	325
NC		325	350
ND		350	375

电压分档

Voltage Code	Unit	Min	Max
V1	V	2.9	3.25
V2		3.25	3.6

色块说明



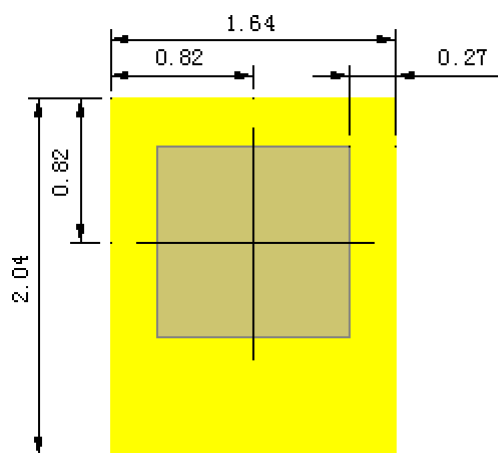
Bin Code	CCT	x	y
A2	5600-6000K	0.310	0.341
		0.314	0.314
		0.321	0.321
		0.319	0.350
A1	6000-6600K	0.319	0.350
		0.321	0.321
		0.329	0.328
		0.329	0.359

说明:

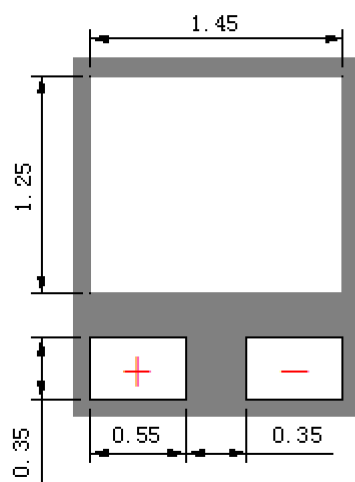
1. 色坐标 (CCx, CCy) 测量误差 ± 0.01 , 测试电流 1000mA, 测试时间 20ms, 环境温度为 25°C

产品尺寸

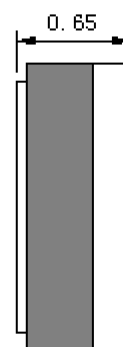
单位：毫米（mm） 未注公差：±0.10



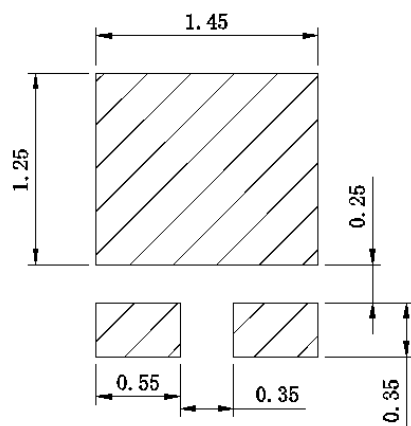
俯视图



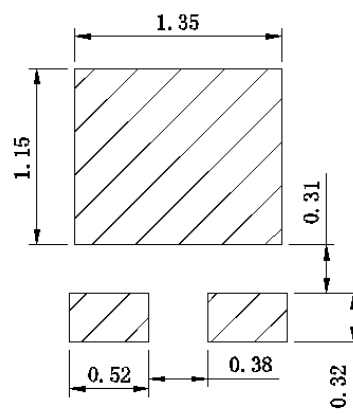
仰视图



侧视图

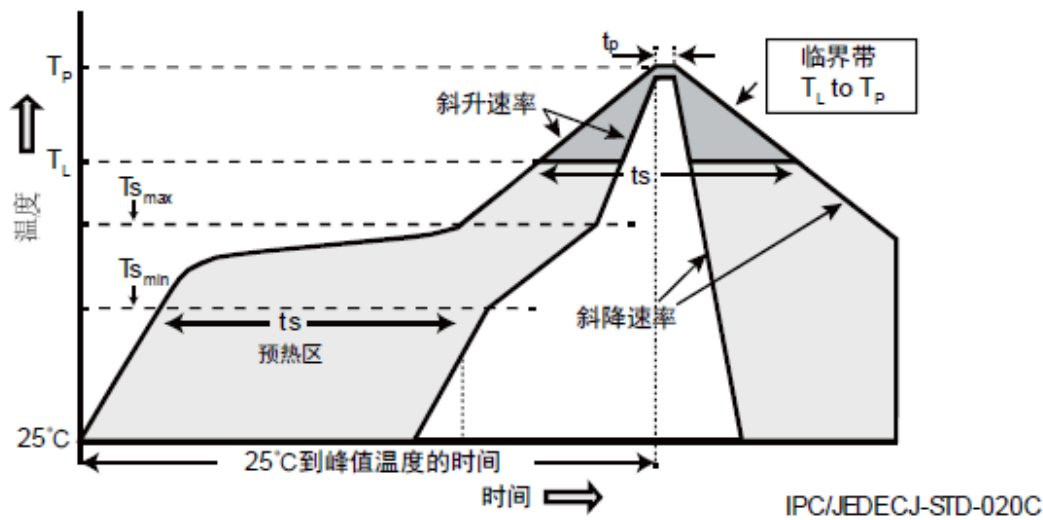


推荐焊盘尺寸



推荐模板尺寸

推荐回流焊温度曲线



温度分布特点	锡铅共晶焊料	无铅焊料
斜升速率 $T_{s_max} \sim T_P$	最大值 3°C/s	最大值 3°C/s
最低预热温度 T_{s_min}	100°C	150°C
最高预热温度 T_{s_max}	150°C	200°C
预热时间 $T_{s_min} \sim T_{s_max}$	$60 \sim 120\text{ s}$	$60 \sim 180\text{ s}$
液相温度 T_L	183°C	217°C
温度维持在 T_L 以上的时间 t_L	$60 \sim 150\text{ s}$	$60 \sim 150\text{ s}$
封装体峰值温度 T_P	215°C	260°C
指定实际峰值温度 5°C 以内的时间 t_p	$10 \sim 30\text{ s}$	$20 \sim 40\text{ s}$
斜降速率 $T_P \sim T_L$	最大值 6°C/s	最大值 6°C/s
25°C 到峰值温度的时间	最大值6分钟	最大值8分钟

说明：1. 温度分布特点参照IPC/JEDEC J-STD-020C.

2. 产品湿气敏感等级1（MSL 1）。

规格：包装数量（标准卷带：3000颗/盘，最小包装：300颗/盘）

单位：毫米（mm）

